学生専用ブースツアー時間表　12/9（水）-11（金）

【申込について】
・事前申込優先（募集早々に枠が埋まる場合もありますのでお早めにお申込みください）
・同じ時間帯のツアーは1つのみ申込可能です。（例：グループ1とグループ2の両方への申込はできません）
・参加できなくなった場合は、他の学生の参加機会確保のため、必ずキャンセル手続きをお願いいたします。

	グループ名	順番	企業名	業種カテゴリー
午前ツアー **集合 11:20** 出発　11:30 終了　12:50	**グループ1**	1	TOWA	半導体製造装置
		2	旭ダイヤモンド工業	半導体材料
		3	大日本印刷	部品・コンポーネント（サブシステム）
		4	マイクロンメモリ ジャパン	半導体デバイス
	グループ2	1	栗田工業	工場設備
		2	荏原製作所	半導体製造装置
		3	ヤマハロボティクス	半導体製造装置
		4	富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ	半導体材料
午後①ツアー **集合 13:20** 出発　13:30 終了　15:00	**グループ3**	1	芝浦メカトロニクス	半導体製造装置
		2	キッツエスシーティー	部品・コンポーネント（サブシステム）
		3	東レリサーチセンター	半導体材料
		4	アドテックプラズマテクノロジー	部品・コンポーネント（サブシステム）
		5	日立ハイテク	半導体製造装置
	グループ4	1	ディスコ	半導体製造装置
		2	住友ベークライト	半導体材料
		3	TOPPAN	部品・コンポーネント（サブシステム）
		4	アスリートFA	工場設備
	グループ5	1	東京エレクトロン	半導体製造装置
		2	ローツェ	半導体製造装置
		3	東レエンジニアリング	半導体製造装置
		4	PILLAR	部品・コンポーネント（サブシステム）
午後②ツアー **集合 15:20** 出発　15:30 終了　16:30	**グループ6**	1	オムロン	工場設備
		2	日本マイクロニクス	半導体製造装置
		3	JX金属	半導体材料
		4	THK	部品・コンポーネント（サブシステム）
	グループ7	1	住友重機械工業	半導体製造装置
		2	キヤノン	半導体製造装置
		3	CKD	部品・コンポーネント（サブシステム）
		4	村田機械	半導体製造装置
	グループ8	1	インテグリス・ジャパン	部品・コンポーネント（サブシステム）
		2	KOKUSAI ELECTRIC	半導体製造装置
		3	クリエイティブテクノロジー	工場設備
		4	カンケンテクノ	半導体製造装置